

文件名：

BGA 助焊膏使用说明书

发布日期：

2007-12-10

## BGA 助焊膏使用说明书

### 1. 特性

- 松香型免洗粘性助焊膏，符合 RoHS。
- 依据 EN14582 方法测试，卤素未检出。
- 应用范围：BGA 植球、返修、元器件拖锡、补焊等。
- 特制焊剂具有很好的热稳定性，提供优良润湿性。
- 回流后残余物少，色浅，无腐蚀，阻抗高。
- 符合 ANSI /J-STD-004A 焊剂 ROL0 型。
- 有效降低焊接不良，减少空洞。
- 适用于空气及氮气回流。
- 粘性强，粘性持久。
- 焊后焊点光亮。

### 2. 性能指标

| 项目     | 指标             |                      | 测试依据                                 |                   |
|--------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 外观     | 淡黄色均匀膏状        |                      | 目视                                   |                   |
| 粘度     | 38 Pa · S(参考值) |                      | Malcom PCU 粘度计，10RPM，25              |                   |
| 坍塌测试   | 通过             |                      | J-STD-005,IPC-TM-650,Method2.4.35    |                   |
| 锡球测试   | 通过             |                      | J-STD-005,IPC-TM-650,Method2.4.43    |                   |
| 润湿性测试  | 通过             |                      | J-STD-005,IPC-TM-650,Method2.4.45    |                   |
| 卤素含量   | 未检出            |                      | J-STD-004A,IPC-TM-650,Method2.3.35   |                   |
| 铜镜腐蚀   | 低              |                      | J-STD-004A,IPC-TM-650,Method2.3.32   |                   |
| 铜板腐蚀   | 轻微腐蚀可接受        |                      | J-STD-004A,IPC-TM-650,Method2.3.32   |                   |
| 氟点测试   | 通过             |                      | J-STD-004A,IPC-TM-650,Method2.3.35.1 |                   |
| 表面绝缘电阻 | 空板             | 测试值(典型)              | J-STD-004A,IPC-TM-650,Method2.6.3.3  |                   |
|        | 24h            | $3.1 \times 10^{10}$ |                                      | $2.5 \times 10^9$ |
|        | 96h            | $2.1 \times 10^{10}$ |                                      | $3.1 \times 10^9$ |
|        | 168h           | $2.5 \times 10^{10}$ |                                      | $3.7 \times 10^9$ |

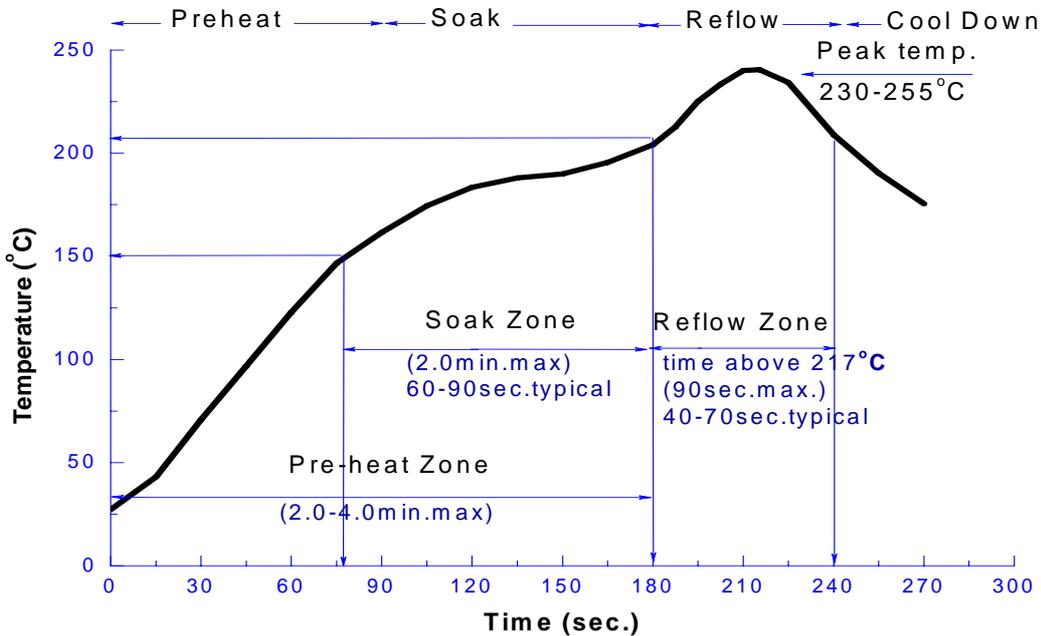
### 3. 印刷参数

使用环境：最佳使用温度为 22 - 28 ，湿度为 60%RH 以下

### 4. 推荐温度曲线

推荐温度曲线 (SnAgCu)

- 预热区 (Preheat) 最大温升为 2.5 /s。
- 保温区 (Soak) 温度 150-210 /s 时间 60-90S 最大温升 2.5 /s。
- 回流区 (Reflow) 最高温度 230-255 217 以上时间 40-70S。
- 冷却区 (Cool down) 最快温降为 4 /s。



## 5. 储存

建议储存 0-10 之间，冷藏有助于保持粘度稳定，自生产日期起 6 个月内使用。

## 6. 使用

- 1) 使用前从冰箱中取出回温到室温。
- 2) 使用前阅读物质安全资料表，做好个人防护。
  - 尽量小心使用焊锡膏，避免接触皮肤，若附于衣服或身体时，应尽快用含酒精的溶剂把焊锡膏抹掉。
  - 不要吸入回流时喷出的蒸汽。
  - 焊接工作后及用餐前要洗手。

## 7. 包装/标示

- 包装：瓶装或针筒
- 标示

每一容器需有以下包装指示：

1. 商标
2. 商品名称
3. 生产批号
4. 使用期限
5. 净重量
6. 注意事项
7. 厂商名称

## 8. 制造商信息

厦门市及时雨焊料有限公司

地址：厦门市湖里区枋湖路 9 - 19 号 5 楼

电话：0592-5713458 5713487

网址：www.jissy.com